



集邦咨询预计 25Q1 NAND 平均合约价降 10~15%， TechInsights 预计 2025 年 HBM 出货量同比增长 70% ——存储芯片周度跟踪（2024.12.30-2025.01.03）

■ 核心观点

NAND: 集邦咨询预计 2025Q1 NAND 平均合约价预测降 10~15%。根据 DRAMexchange，上周（20241230-20250103）NAND 颗粒 22 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.79%至 3.08%，平均涨跌幅为 0.47%。其中 3 个料号价格持平，11 个料号价格上涨，8 个料号价格下跌。根据 IT 之家援引 TrendForce 集邦咨询报告，预测 2025 年第 1 季度 NAND Flash 平均合约价环比下降 10~15%；DRAM 合约价环比下降 8~13%。集邦咨询预测，2025 年第 1 季度 NAND Flash 市场将面临严峻挑战，供货商库存持续上升，订单需求下降，平均合约价预计将环比下降 10% 至 15%。

DRAM: 铠侠宣布已开发出 OCTRAM 技术。根据 DRAMexchange，上周（20241230-20250103）DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.24%至 1.43%，平均涨跌幅为 0.09%。上周 7 个料号呈上涨趋势，9 个料号呈下降趋势，2 个料号价格持平。根据 CFM 闪存市场报道，铠侠宣布已开发出 OCTRAM 技术，这是一种新型 4F² DRAM，由兼具高导电流和超低漏电流的氧化物半导体晶体管组成。该技术采用 InGaZnO（铟镓锌氧化物）晶体管，可将漏电率降低到极低水平，从而降低 DRAM 功耗。

HBM: TechInsights 预计 2025 年 HBM 出货量将同比增长 70%。根据科创板日报援引 TechInsights 报告，随着 AI 的兴起，特别是在机器学习和深度学习等数据密集型应用中，对高带宽内存（HBM）的需求空前高涨。预计 2025 年 HBM 出货量将同比增长 70%，因为数据中心和 AI 处理器越来越多地依赖这种类型的存储器来处理低延迟的大量数据。HBM 需求的增长预计将重塑 DRAM 市场，制造商将优先生产 HBM，而不是传统的 DRAM 产品。

市场端: 行业 SSD 和内存条价格普降。根据 CFM 闪存市场报道，随着前段时间渠道部分低端 BGA 颗粒缺货不断，渠道厂商跟随市场情况适时试涨部分低容量 SSD 成品，近期部分渠道客户已然接受涨价并陆续有实单成交，涨价效应初步显现。而行业市场因少数存储厂商压低价格，PC 终端客户对价格接受度普遍较低，令行业 SSD 和内存条价格普降。嵌入式方面，低容量 eMMC 在货源相对紧缺且需求有撑下仍然强势续涨，而其余产品需求则较为寡淡。

■ 投资建议

我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的 HBM 产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。

HBM: 受益于算力芯片提振 HBM 需求，相关产业链有望迎来加速成长，建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等；

存储芯片: 受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI 带动 HBM、SRAM、DDR5 需求上升，产业链有望探底回升。推荐东芯股份，建议关注兆易创新、恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利等。

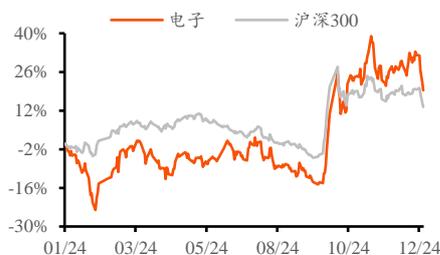
■ 风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

增持(维持)

行业： 电子
日期： 2025年01月21日
分析师： 陈宇哲
E-mail: chenyzhe@yongxingsec.com
SAC编号: S1760523050001
联系人： 林致
E-mail: linzhi@yongxingsec.com
SAC编号: S1760123070001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

相关报告:

《美光或下调 10% NAND 闪存产能利用率，铠侠宣布已开发出 OCTRAM 技术》

——2024 年 12 月 31 日

《三星电子或建 10nm 第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主》

——2024 年 12 月 24 日

《Marvell 推出定制 HBM 计算架构，现货市场价格保持稳定》

——2024 年 12 月 23 日

正文目录

1. 存储芯片周度价格跟踪	3
2. 行业新闻	4
3. 公司动态	6
4. 公司公告	7
5. 风险提示	8

图目录

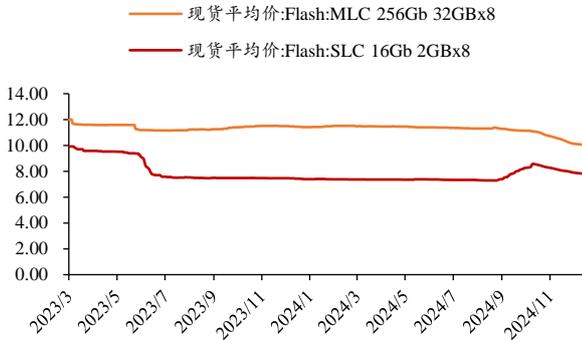
图 1: NAND 中大容量现货价格 (美元)	3
图 2: NAND 中小容量现货价格 (美元)	3
图 3: NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)	3
图 4: NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)	3
图 5: DRAM 中大容量现货价格 (美元)	3
图 6: DRAM 中小容量现货价格 (美元)	3

表目录

表 1: 存储行业本周重点公告 (2024.12.30-2025.1.03)	7
--	---

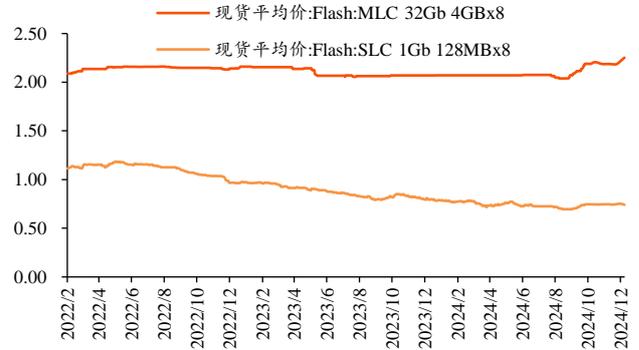
1. 存储芯片周度价格跟踪

图1:NAND 中大容量现货价格 (美元)



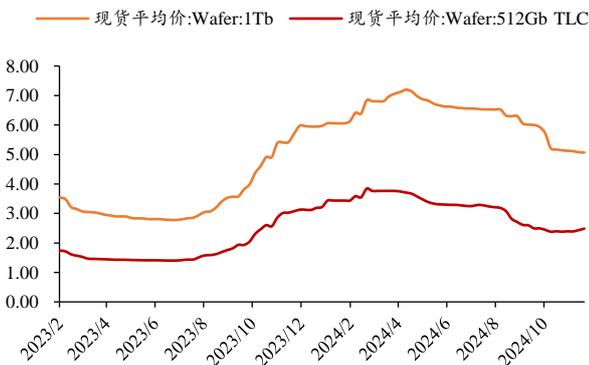
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图2:NAND 中小容量现货价格 (美元)



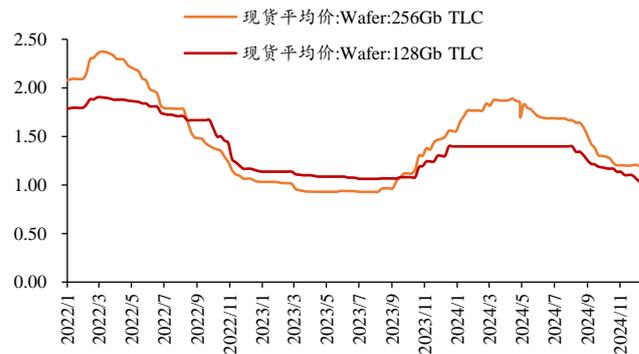
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图3:NAND Wafer 中大容量现货价格 (美元)



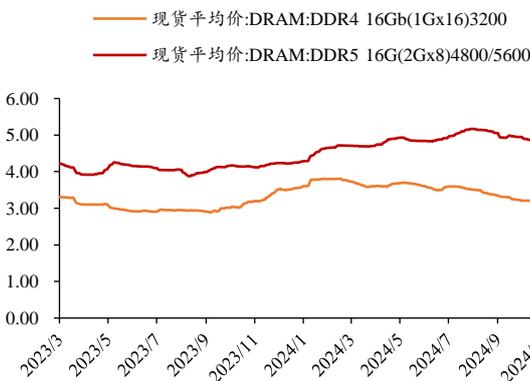
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图4:NAND Wafer 中小容量现货价格 (美元)



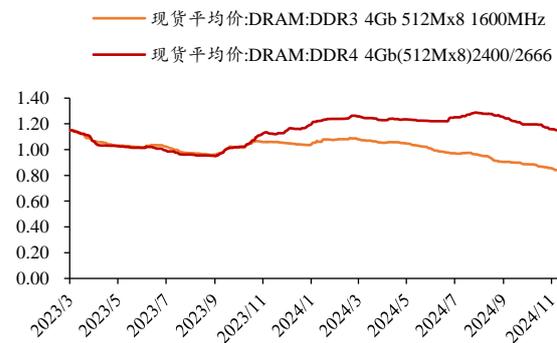
资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图5:DRAM 中大容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

图6:DRAM 中小容量现货价格 (美元)



资料来源: iFind, 甬兴证券研究所

2. 行业新闻

涨价效应显现，个别渠道 SSD 成品价格反弹，行业存储现货价格普遍向下调整

12 月 31 日，根据 CFM 闪存市场报道，随着前段时间渠道部分低端 BGA 颗粒缺货不断，渠道厂商跟随市场情况适时试涨部分低容量 SSD 成品，近期部分渠道客户已然接受涨价并陆续有实单成交，涨价效应初步显现。而行业市场因少数存储厂商压低价格，PC 终端客户对价格接受度普遍较低，令行业 SSD 和内存条价格普降。嵌入式方面，低容量 eMMC 在货源相对紧缺且需求有撑下仍然强势续涨，而其余产品需求则较为寡淡。

资料来源：(CFM 闪存市场)

集邦咨询：库存高企需求疲软，2025Q1 NAND 平均合约价预测降 10~15%

1 月 1 日，根据 IT 之家援引 TrendForce 集邦咨询报告，预测 2025 年第 1 季度 NAND Flash 平均合约价环比下降 10~15%；DRAM 合约价环比下降 8~13%。集邦咨询最新调查预测，2025 年第 1 季度 NAND Flash 市场将面临严峻挑战，供货商库存持续上升，订单需求下降，平均合约价预计将环比下降 10% 至 15%。Wafer 价格跌幅将有所收敛，而模组产品方面，由于企业级固态硬盘（Enterprise SSD）订单稳定，价格跌势有望得到缓冲；但客户端固态硬盘（Client SSD）和通用闪存存储（UFS）由于消费终端产品需求疲软，买家采购意愿低迷，价格将持续下探。

资料来源：(IT 之家)

铠侠宣布已开发出 OCTRAM 技术

12 月 27 日，根据 CFM 闪存市场报道，铠侠宣布已开发出 OCTRAM（OCTRAM: Oxide-Semiconductor Channel Transistor DRAM，氧化物半导体晶体管 DRAM）技术，这是一种新型 4F² DRAM，由兼具高导通电流和超低漏电流的氧化物半导体晶体管组成。该技术采用 InGaZnO（铟镓锌氧化物）晶体管，可将漏电率降低到极低水平，从而降低 DRAM 功耗。该技术有望降低各种应用的功耗，例如人工智能、后 5G 通信系统和物联网产品。同时也适用于内存级存储（SCM）技术，以及适配高密度和高性能的新型 3D NAND FLASH。

资料来源：(CFM 闪存市场)

TechInsights：预计 2025 年 HBM 出货量将同比增长 70%

12 月 25 日，根据科创板日报援引 TechInsights 报告，随着 AI 的兴起，特别是在机器学习和深度学习等数据密集型应用中，对高带宽内存（HBM）的需求空前高涨。预计 2025 年 HBM 出货量将同比增长 70%，因为数据中心和 AI 处理器越来越多地依赖这种类型的存储器来处理低延迟的大量数据。

HBM 需求的增长预计将重塑 DRAM 市场，制造商将优先生产 HBM，而不是传统的 DRAM 产品。

资料来源：(科创板日报)

3. 公司动态

【兆易创新】已推出 DDR4、DDR3L 等产品，目前在售产品无 DDR5

12 月 30 日，兆易创新在投资者互动平台回答称，公司积极切入 DRAM 存储器利基市场（消费、工控等），并已推出 DDR4、DDR3L 等产品，目前在售产品无 DDR5。公司于 2024 年 11 月发布《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》，将募投项目“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途调整为 DDR3、DDR4、LPDDR4 和 LPDDR5。

资料来源：（投资者互动平台）

【壹石通】low- α 球形氧化铝可以用于玻璃基板封装

12 月 31 日，壹石通在投资者互动平台回答称，公司 low- α 球形氧化铝可以用于玻璃基板封装。无论哪种基板，都需要在基板上进行 Memory（内存）、CPU（中央处理器）及/或 HBM（HighBandwidthMemory，高带宽存储器）等封装。

资料来源：（投资者互动平台）

4. 公司公告

表1: 存储行业本周重点公告 (2024.12.30-2025.1.03)

日期	公司	公告类型	要闻
2025/1/2	东芯股份	控股股东增持进展	<p>控股股东东方恒信集团有限公司自 2024 年 10 月 21 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 2.0 亿元（含）且不高于人民币 2.4 亿元（含）。截至 2024 年 12 月 31 日收盘，上述相关增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,839,810 股，占公司总股本 0.8682%，增持金额合计人民币 104,939,410.50 元，已超过本次增持计划拟增持金额区间下限的 50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。</p>
2025/1/2	恒烁股份	股份回购进展	<p>恒烁半导体（合肥）股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 52.51 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 399,082 股，占公司总股本 82,637,279 股的比例为 0.48%，回购成交的最高价为 39.60 元/股，最低价为 35.85 元/股，支付的资金总额为人民币 15,200,055.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。</p>

资料来源 Wind，甬兴证券研究所

5. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。